

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*10年分まとめてCD1枚に収録!

貴金属メッキ方法と工程

公報種別 収録年数 収録点数
 [公告・登録・公開編] 平成7年～平成16年(10年間) 740点

全文PDF CD-ROM 版 合計¥226,100 ¥129,150 - (税込価格)

		収録既刊セット			(本体価格)
No,9782	登録・公開特許	貴金属メッキ方法と工程	平.16	85点	¥19,600
No,9642	"	"	平.15	76点	¥17,700
No,9443	"	"	平.14	76点	¥17,700
No,9255	"	"	平.13	74点	¥19,000
No,9036	"	"	平.12	66点	¥23,100
No,8811	"	"	平.11	76点	¥26,600
No,8592	"	"	平.10	75点	¥27,000
No,8350	"	"	平.9	74点	¥26,700
No,8087	公告・公開特許	"	平.8	66点	¥23,400
No,7949	"	"	平.7	72点	¥25,300

(収録点数・内容は予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。)

今までお客様にご愛顧頂いております「特許収録セット」を、約10年分のデータを集結した「特許収録セット10年セット版」をご用意いたしました。過去10年間に発行いたしました各テーマの収録セットの内容を全てCD一枚に収録し、検索機能もできるCD-ROM版と同様に「しおり機能」「ハイパーリンク機能」の2大機能を付加してお届けします。

しかも!過去10年間の特許収録セットをまとめた上に、お値段は全収録セット合計金額の

30～50%OFF!! という超お買得商品としてご提供いたします!

またご希望のお客様には平成6～15年版の「Vol.3」もご用意しております。

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[10年セット版はPDFファイルに「しおりリンク機能」、目次に「ハイパーリンク機能」を付加しております。]

ご注文頂きましたら6～7営業日中に請求書同封の上お送り致します。

お 申 込 書

会 社 名	ご 注 文 内 容
	ニュースガイド No. X006 (Vol.4) CD-ROM版
所 属 部 署	題 名 「 貴金属メッキ方法と工程 (10年セット版)」 合計(税込価格)¥ 129,150 -
担 当 者 名	E-mail () FAX ()
住所 〒	

料金には別途送料がかかります。

貴金属メッキ方法と工程

No.X006(Vol.4)

[公告・登録・公開編]

平成7年～平成16年(10年間)

740点

CD-ROM版 ¥129,150 (税込価格)

日本特許公開 平成7年

- 銀特有の銀色を変じない銀製品又は銀被覆を施した金属製品 水庫 成浩
- 銀-錫合金めっき沈着浴 ヴェー・ツェー・ヘレウス・ゲゼルシャフト・ミット...
- 貴金属製品の製造法 有限会社ヤマダ
- 半導体装置の金属導体の形成方法 沖電気工業株式会社
- 半導体素子用複合ボンディングワイヤおよび半導体装置 田中貴金属工業株式会社

日本特許公開 平成8年

- 装飾用銀めっき液 小島化学薬品株式会社
- 非シアン性貴金属めっき浴 荏原ユーザライト株式会社
- 銀めっき浴及び銀めっき方法 日本エレクトロプレイティング...
- 貴金属めっきの製造方法材およびその製造方法 古河電気工業株式会社
- 半導体チップ実装用リードフレーム 古河電気工業株式会社

日本特許公開 平成9年

- 金めっき用非水性浴 株式会社山王
- 亜硫酸金めっき液 新光電気工業株式会社
- マスク構造体、その製造方法、該マスク構造体を用いた露光方法及び露光装置、該マスク構造体を用いて...
- 金箔の製造方法 三菱マテリアル株式会社
- リードフレーム 日立金属株式会社
- 鉄系リードフレームの処理方法及びリードフレーム 大日本印刷株式会社

日本特許公開 平成10年

- 光沢錫-銀合金電気めっき浴 石原薬品株式会社
- 錫-銀合金酸性電気めっき浴 ディップソール株式会社
- Pd-Sn系合金メッキ液及びメッキ部材 株式会社ビクトリア
- 電子部品 芹沢 精一
- 気密端子および部分めっき治具および部分めっき方法 松下電器産業株式会社
- 基盤の表面上に金属層を作成する方法 モトローラ Inc.
- 非シアン系銀メッキ浴 日本エレクトロプレイティング...

日本特許公開 平成11年

- めっき浴 株式会社大和化成研究所
- 配線基板のメッキ用マスクング方法 日本特殊陶業株式会社
- 金めっき液及び金めっき方法 新光電気工業株式会社
- パラジウム電気めっき液 松田産業株式会社
- イリジウム表面にロジウムを被覆処理した工業構造物材料及びその製造方法 石福金属興業株式会社
- 錫-銀はんだ合金めっき層の形成方法 日鉱金属株式会社

日本特許公開 平成12年

- 選択的なパラジウムめっきを有するリードフレーム テキサス インストルメンツインコーポレイテッド
- 金属を還元析出させるための水溶液 株式会社大和化成研究所
- はんだ濡れ性に優れたリードフレーム用銀めっき材 株式会社神戸製鋼所
- リードフレーム及びその製造方法 ソニー株式会社
- 柔軟性のあるケーブル用線状導体の製造方法 株式会社三晃製作所

日本特許公開 平成13年

- 耐熱、耐食性銀めっき材 日鉱金属株式会社
- 化学気相堆積により堆積した銅の密着性を高める方法 アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- プリント基板、及びプリント基板への部分メッキ方法 富士機工電子株式会社
- 硫酸テトラアミンパラジウムの製造方法 ルーセント テクノロジーズインコーポレイテッド
- 電気コネクタと、電気メッキ浴と、耐摩耗性表面を形成する方法 ルーセント テクノロジーズインコーポレイテッド

日本特許公開 平成14年

- 無電解金めっき液及びその建浴方法 株式会社日立製作所
- 水溶性イリジウムめっき浴及びそのめっき方法 日本エレクトロプレイティング...
- 金合金メッキ液 セイコーインストルメンツ株式会社
- 微小めっき部位を有するめっき物のめっき装置 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社
- 装飾部材 松本 洋介
- パラジウムメッキ液及び該メッキ液を用いたパラジウムメッキ方法 株式会社ビクトリア

日本特許公開 平成15年

- 被覆金属製品 ルーセント テクノロジーズインコーポレイテッド
- 置換金メッキ液 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社
- 金めっき液 日本高純度化学株式会社
- 装飾品およびその製造方法 シチズン時計株式会社
- 配線板およびその製造方法 松下電器産業株式会社
- コンタクト 日本航空電子工業株式会社
- 導電性微粒子及び基板構成体 積水化学工業株式会社

日本特許公開 平成16年

- 金属多孔体および該金属多孔体の製造方法 片山特殊工業株式会社
- シリコンとの貴金属電極接点のための方法 インターナショナル・ビジネス・マシーンス・コーポレーション
- 光ファイバへの電解メッキ方法 古河電気工業株式会社
- 金メッキ液および金メッキ方法 三菱化学株式会社
- 電気化学セルおよび電気化学セルのための交換可能電解質 フィッター、ヨハン・セー
- 通電性を有する構造体および該構造体を用いた電気メッキ方法 株式会社クリエイティブクジヤパン

各年度より抜粋